

LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

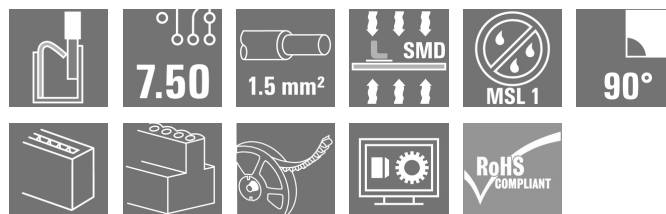
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



革新的で迅速な操作に対応するコネクタ – 簡易で、安全で、そして経済的：

バネ接続および直接のプッシュイン技術搭載 PCB 端子。接続技術における画期的製品。

驚くほど簡易で、実際にも驚異的な製品です：

- ツール不要で、フェルール端子を使用してソリッドワイヤまたは導体を接続し、簡単に接続解除ができます
- リフローまたは気相による自動処理
- 色分け押しボタンで明確に識別された電位およびクランプポイント

世界最高クラスの形状と処理フェーズで、幅広いアプリケーションに適しています。

リフローはんだ付けによる全自動組立対応プリント基板端子 (SMD)、プッシュイン接続搭載。同方向からの電線挿入とスライダー操作 (TOP)

- フェルールを取付けた撚り線や単線は、挿入するだけで接続可能です。
- フェルール無しの撚り線を接続する場合、クランプ部を開くためにレバーもしくはボタンを使用します。
- 電線挿入部と操作部が明確に分かれているため、直感的な操作が可能です。
- テープオンリール梱包
- 電線接続方向 90°

一般注文データ

バージョン	プリント基板端子台, 7.50 mm, 極数: 5, 90°, 黒色, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 1.5 mm², Tape
注文番号	1473970000
種別	LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL
GTIN (EAN)	4050118281033
数量	320 Stück
製品データ	IEC: 800 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
パッケージ	Tape

LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	14.75 mm	奥行き (インチ)	0.581 inch
高さ	9.65 mm	高さ (インチ)	0.38 inch
下位バージョンの高さ	9.65 mm	幅	34.2 mm
幅 (インチ)	1.346 inch	正味重量	4.86 g

温度

連続動作温度、最大	120 °C
-----------	--------

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATEシグナル - シリーズLSF	導体接続方法	アクチュエータ付プッシュイン
PCB の取り付け	SMDはんだ接続	導体取り出し方向	90°
ピッチ (mm) (P)	7.5 mm	ピッチ (インチ) (P)	0.295 "
極数	5	ピンモデルシリーズ数量	1
顧客による実装済	いいえ	行数	1
共平面性:	100 µm	極当たりソルダーピン数	2
被覆剥き長さ	8 mm	L1 (mm)	30 mm
L1 (インチ)	1.18 "	DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP 20
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	フィンガータッチセーフ	保護度合い	IP20
体積抵抗	1.60 mΩ		

材料データ

絶縁材	LCP GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
はんだ接続の層構造	4...6 µm Sn matt	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	120 °C	温度範囲、設置、最小	-30 °C
温度範囲、設置、最大	120 °C		

接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
クランプ範囲、最大	1.5 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 28
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 14
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.2 mm ²
固定式、最大 H05 (07) V-U	1.5 mm ²
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.2 mm ²
フレキシブル、最大 H05 (07) V-K	1.5 mm ²
w. プラスチックカラーフェールール、DIN 0.25 mm ² 46228 pt 4、最小	
プラスチックカラー付フェールール DIN 0.75 mm ² 46228 pt 4、最大	
w. フェールール、DIN 46228 pt 1、最小 0.25 mm ²	
ワイヤエンドフェールール付 DIN 46228 1.5 mm ² pt 1、最大	

作成日 2024/07/04 8:31:24 CEST

LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ


クランプ導体	導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	フェルール端子	公称	0.25 mm ²
		被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	H0.25/12 HBL
	導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	フェルール端子	公称	0.34 mm ²
		被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	H0.34/12 TK
	導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	フェルール端子	公称	0.5 mm ²
		被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	H0.5/14 OR
	導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	フェルール端子	公称	0.75 mm ²
		被覆剥き長さ	公称 10 mm
		推奨フェルール端子	H0.75/14T HBL

参照テキスト フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません


IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	17.5 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	17.5 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	17.5 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	15 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	800 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	630 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	500 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	6 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	6 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3	6 kV	短時間耐電流抵抗	3 x 1sで80 A

CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)		証明書番号 (CSA)	200039-1664286
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電圧 (グループ C / CSA 使用)	150 V
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V	定格電流 (グループ B/CSA 使用)	10 A
定格電流 (グループ C / CSA 使用)	10 A	定格電流 (グループ D/CSA 使用)	10 A
導体断面積、AWG、最小	AWG 28	導体断面積、AWG、最大	AWG 14
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)		証明書番号 (cURus)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V	定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)	150 V
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V	定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	12 A
定格電圧 (使用グループ C/UL 1059)	10 A	定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	10 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 28	導体断面積、AWG、最大	AWG 14
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

作成日 2024/07/04 8:31:24 CEST

LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

梱包

ESD レベルのパッケージ	静電気散逸	パッケージ	Tape
VPE 長	331 mm	VPE幅	331 mm
VPEの高さ	67 mm	テープの深さ (T2)	10.9 mm
テープ幅 (W)	56 mm	テープポケットの深さ (K0)	10.4 mm
テープポケットの高さ (A0)	15.1 mm	テープポケット幅 (B0)	42.2 mm
テープポケットの分離 (P1)	20 mm	テープホルルの分離 (E)	1.75 mm
テープポケットの分離 (F)	26.2 mm	テープリール径φ (A)	330 mm
表面抵抗	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$		

テストの種類

試験：マーキングの耐久性	テスト	原産地表示, 種類の識別, ピッチ, 承認マーキング
	評価	UL, 耐久性 使用可能
テスト：クランプ可能な断面	標準	DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 12.02
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.14 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線0.14 mm ²
		導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
		導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする	標準	DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00
	要件	0.2 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
	評価	合格した
	要件	0.3 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 撚線0.25 mm ²
		導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm ²
	評価	合格した
	要件	0.4 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した

LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

引き抜き試験	標準	DIN EN 60999-1 セクション 9.5 / 12.00
	要件	≥10 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 24/1
		導体の種類と導体断面 AWG 24/19
	評価	合格した
	要件	≥20 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 撚線 0.25 mm ²
		導体の種類と導体断面 H05V-U0.5
	評価	合格した
	要件	≥40 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 H07V-U1.5
		導体の種類と導体断面 H07V-K1.5
		導体の種類と導体断面 AWG 16/1
		導体の種類と導体断面 AWG 16/19
	評価	合格した

分類

ETIM 6.0	EC002643	ETIM 7.0	EC002643
ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ECLASS 9.0	27-44-04-01	ECLASS 9.1	27-44-04-01
ECLASS 10.0	27-44-04-01	ECLASS 11.0	27-46-01-01
ECLASS 12.0	27-46-01-01	ECLASS 13.0	27-46-01-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

重要なメモ

IPC 準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none">• 要求に応じて追加のプッシュボタンの色• スライダの作動力は最大40 N• 定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。• プラスチック製カラー付きワイヤエンドフェルールをDIN 46228/4に• プラスチック製カラーのないワイヤエンドフェルールをDIN 46228/1に• 図面上のP = ピッチ• 公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。• PZ 6/5 圧着工具を備えたワイヤエンドフェルールの圧着形状「A」をお勧めします。• 平均温度 50 °C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

作成日 2024/07/04 8:31:24 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cURus)	E60693

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Declaration of the Manufacturer
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
製品変更通知	Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel” Produkten
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL DRIVES EN PI OMNIMATE LSF SMD EN FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL DRIVES DE FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
ホワイトペーパーの表面取り付け技術	Download Whitepaper

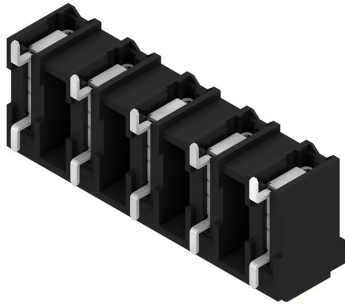
LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

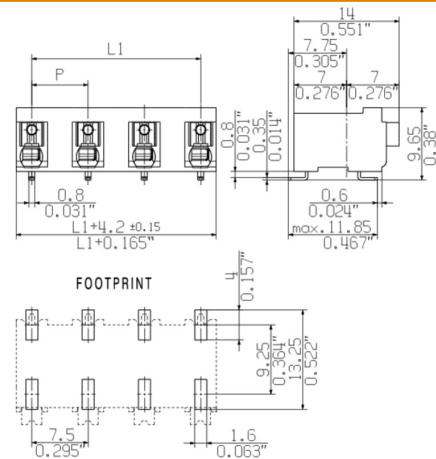
www.weidmueller.com

四面

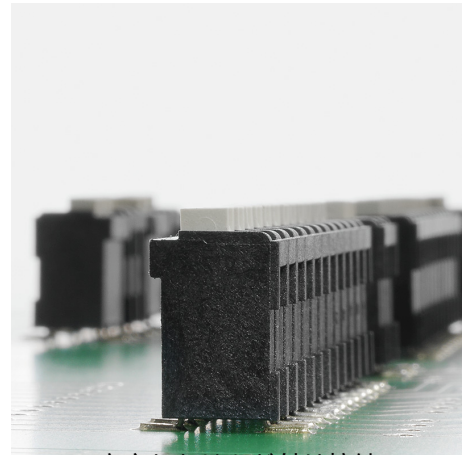
製品イメージ



寸法図

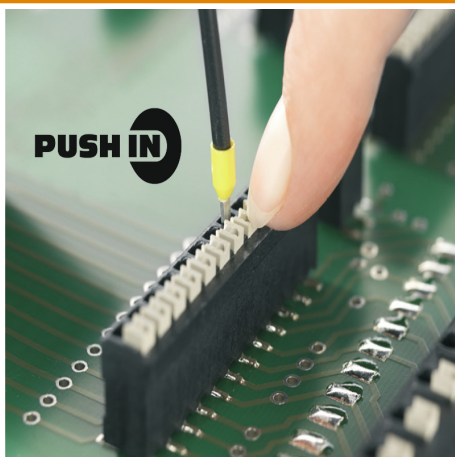


製品の利点



安定したはんだ付け接続

製品の利点



PUSH IN導体接続

製品の利点



テープオンリールの梱包

LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9009030000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266944	
数量	1 Stück	

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 0.4X2.5X75	バージョン
注文番号	9008370000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056330	
数量	1 Stück	

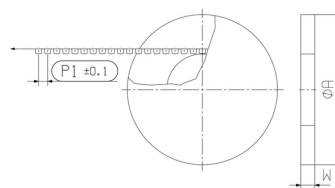
LSF-SMD 7.50/05/90 SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

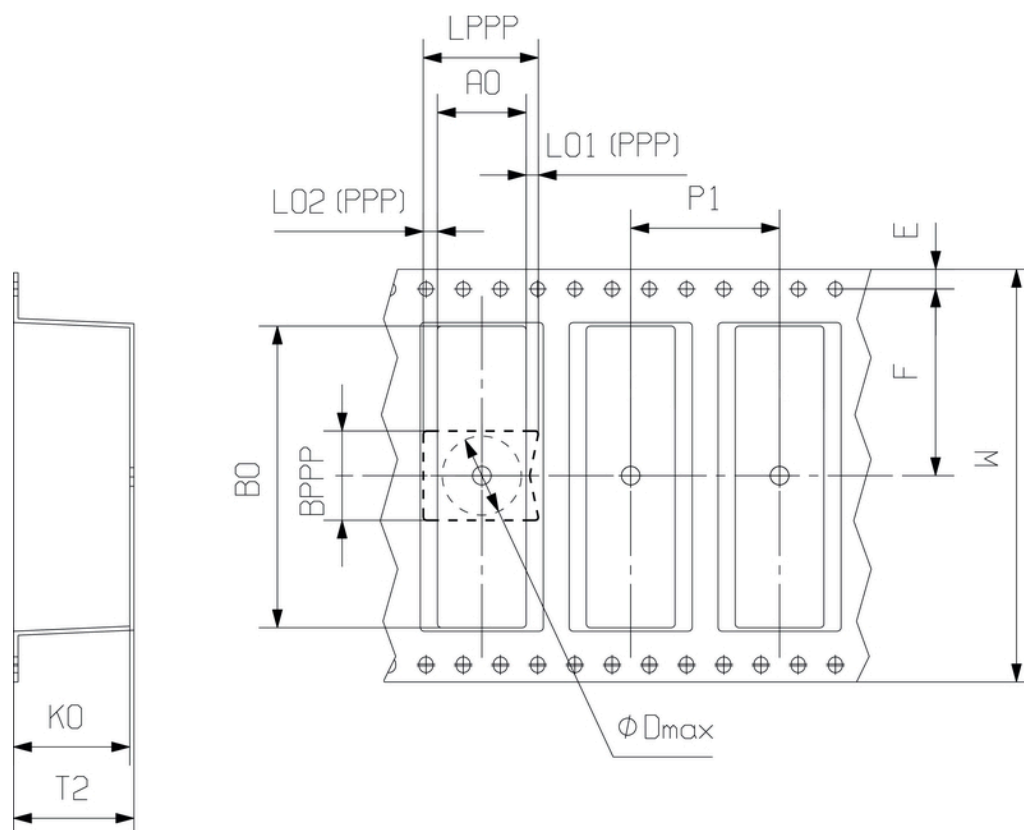
www.weidmueller.com

図面

寸法図

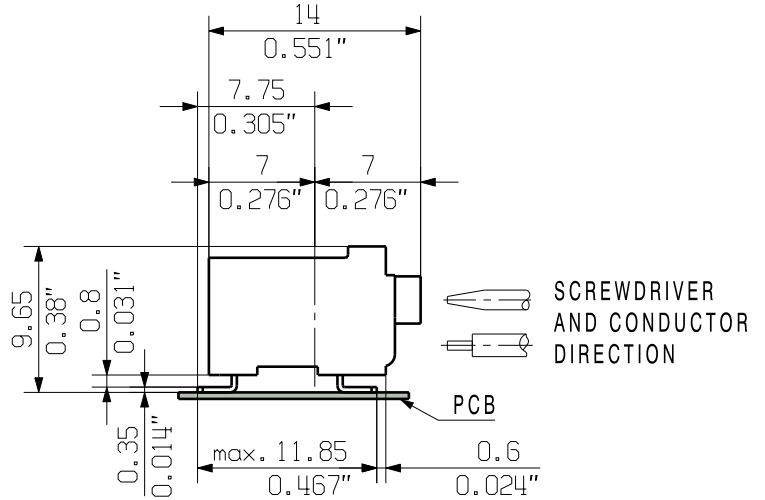
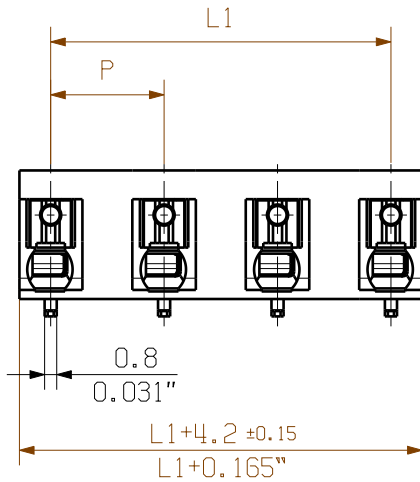


寸法図

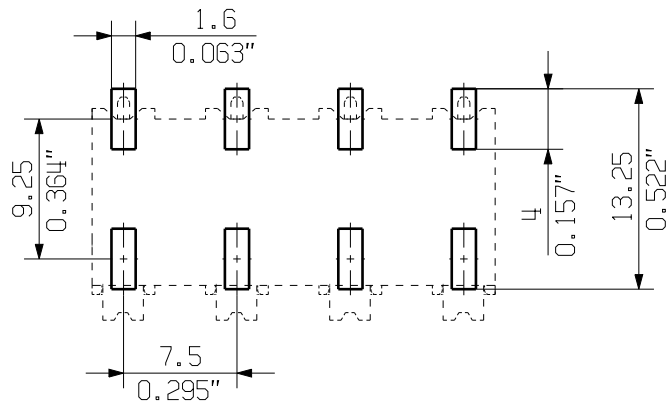


DIRECTION OF UNREELING 

ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED



FOOTPRINT

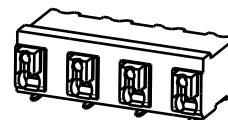


For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.
The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.
Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

P = 7.50 RASTER PITCH

M 1/1



6	37.50	1.476
5	30.00	1.181
4	22.50	0.886
3	15.00	0.591
2	7.50	0.295
n	POLZAHL POLES	L1 [mm] L1 [inch]

GENERAL TOLERANCE:
DIN ISO 2768-m



77586/5
01.08.14 HELIS_MA 00

MODIFICATION

Weidmüller

C 57964 02

DRAWING NO. SHEET 02 OF 02 SHEETS ISSUE NO.



DATE NAME

DRAWN 11.03.2014 HELIS_MA

RESPONSIBLE KRUG_M

CHECKED 05.08.2014 HELIS_MA

APPROVED LANG_T

SCALE: 2/1

SUPERSEDES: .

LSF-SMD 7.50/.. /90...
LEITERPLATTENKLEMM
PCB TERMINAL

PRODUCT FILE: LSF-SMD

7401

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.